

# タツモ株式会社

- Technology for People's Future -

---

2019年12月期 決算説明資料

**本資料は、2020年2月14日発表の決算短信に基づいて作成されております。**

**また、本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績はさまざまな要因により予想数値と異なる場合があります。**

**掲載内容には細心の注意を払っておりますが、掲載された内容に基づいて被った損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。**

➤ **会社概要**

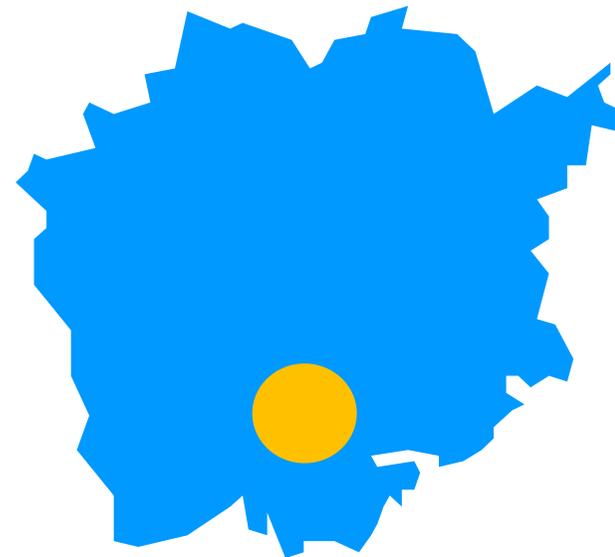
➤ **事業概要**

➤ **決算概要**

➤ **業績予想**

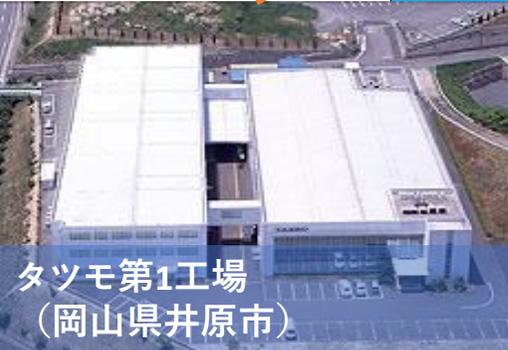
➤ **参考資料**

- ◆ 商号 タツモ株式会社
- ◆ 設立 1972年（昭和47年）2月26日
- ◆ 本社所在地 岡山県岡山市北区芳賀5311
- ◆ 資本金 27億2,406万7,238円
- ◆ 発行済株式数 13,508,300株
- ◆ 株主数 4,463名
- ◆ 従業員数 279名（連結 1,093名）
- ◆ 事業内容 半導体製造装置  
各種搬送ロボット  
液晶製造装置  
精密金型・樹脂成形品  
などの開発・製造・販売



# 会社概要

# TAZMO®



# 会社概要

# TAZMO®



富萊得科技(東莞)有限公司  
(中国 東莞)



上海龍雲精密機械有限公司  
(中国 上海)



龍雲阿普理夏电子科技有限公司  
(中国 上海)



富萊得(香港)有限公司  
(中国 香港)



FACILITY HANOI CO.,LTD.  
(ベトナム ブンイエン省 ヴァンラム県)



TAZMO VIETNAM CO.,LTD.  
(ベトナム ロンアン省 カンジュオク県)



亞普恩科技股份有限公司  
(台湾 新竹縣)



TAZMO INC  
(米国 サンフランシスコ)

➤ 会社概要

➤ **事業概要**

➤ 決算概要

➤ 業績予想

➤ 参考資料

## 事業の全体像

半導体製造装置、搬送ロボット、液晶製造装置、精密金型、樹脂成形品、めっき処理装置等の開発・製造・販売等を行う

事業区分大

プロセス機器事業

金型・樹脂成形事業

表面処理用機器事業

事業区分小

半導体製造装置

搬送機器

洗浄機

コーター

金型・樹脂成形

表面処理用機器

売上高  
(同構成比)

2018 27.3  
(14.4%)

2018 46.9  
(24.6%)

2018 24.0  
(12.6%)

2018 43.8  
(23.0%)

2018 17.3  
(9.1%)

2018 30.8  
(16.2%)

単位：億円

2019 25.5  
(14.0%)

2019 57.2  
(31.4%)

2019 19.0  
(10.5%)

2019 24.1  
(13.2%)

2019 14.3  
(7.9%)

2019 41.8  
(23.0%)

属する業界

半導体製造装置業界

FPD<sup>(1)</sup>製造装置  
業界

金型・樹脂成形  
業界

PCB<sup>(2)</sup>業界

1. フラットパネルディスプレイ  
2. 電子回路基板

## 半導体製造装置事業

半導体製造に用いられる薬液の塗布・現像装置や、シリコンウェーハ薄化のために支持体とウェーハを仮接合・剥離する装置等の開発・製造・販売



薬液塗布装置



貼合装置

## 搬送機器事業

半導体製造装置に用いられるシリコンウェーハ等搬送ロボットやアライメント機器、またそれらをユーザー別の仕様にユニット化した製品等の開発・製造・販売



6軸搬送ロボット

## 洗浄装置事業

半導体製造に用いられるシリコンウェーハ洗浄装置や、スラリーの供給装置、リン酸再生システムなどの開発・製造・販売



枚葉洗浄装置



リン酸再生SYS

## コーター事業

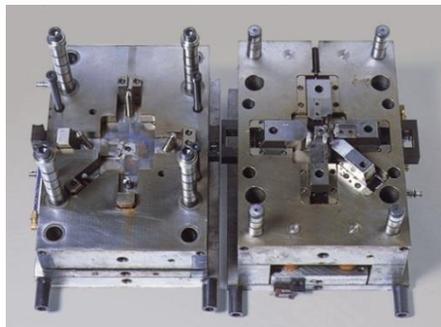
液晶カラーフィルター製造装置向けを中心としたガラス基板への薬液塗布装置の開発・製造・販売



CF塗布装置

## 金型・樹脂成形事業

電子機器部品用の金型の製作及びその金型を使ったコネクタ等の樹脂成形品、エンボスキャリアテープの製造



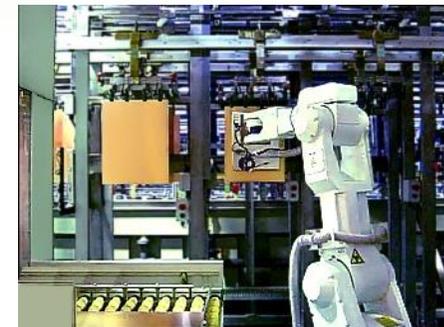
射出成形金型



真空ロータリー金型

## 表面処理用機器事業

めっき処理装置や回路形成装置等のプリント基板製造装置等の開発・製造・販売



垂直連続電気めっき装置（VCP）

➤ 会社概要

➤ 事業概要

➤ **決算概要**

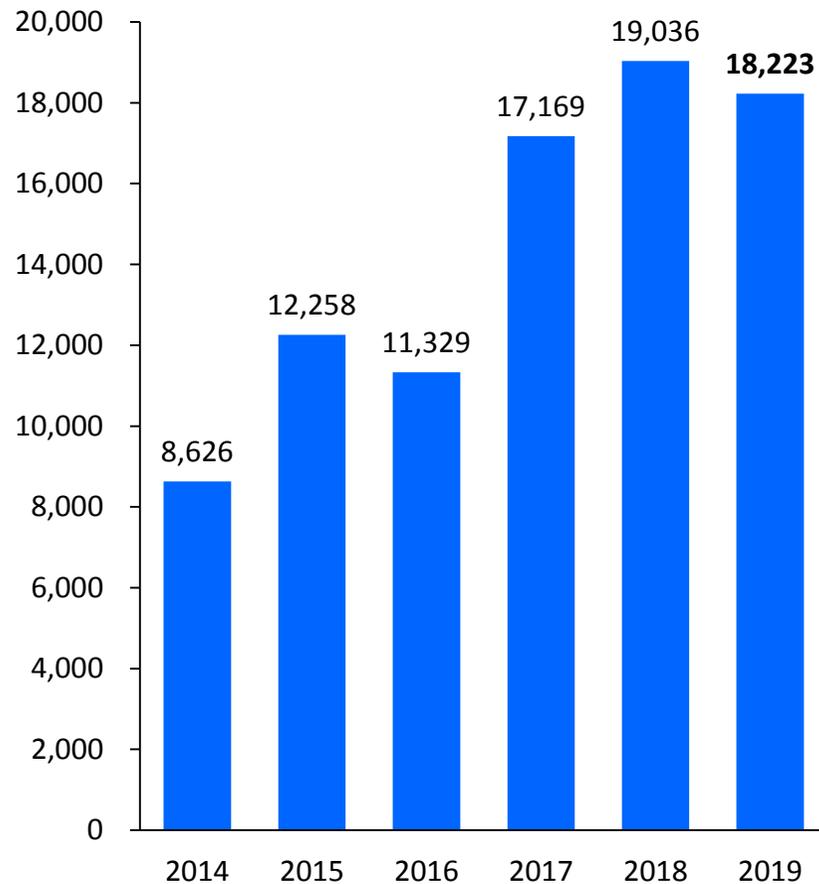
➤ 業績予想

➤ 参考資料

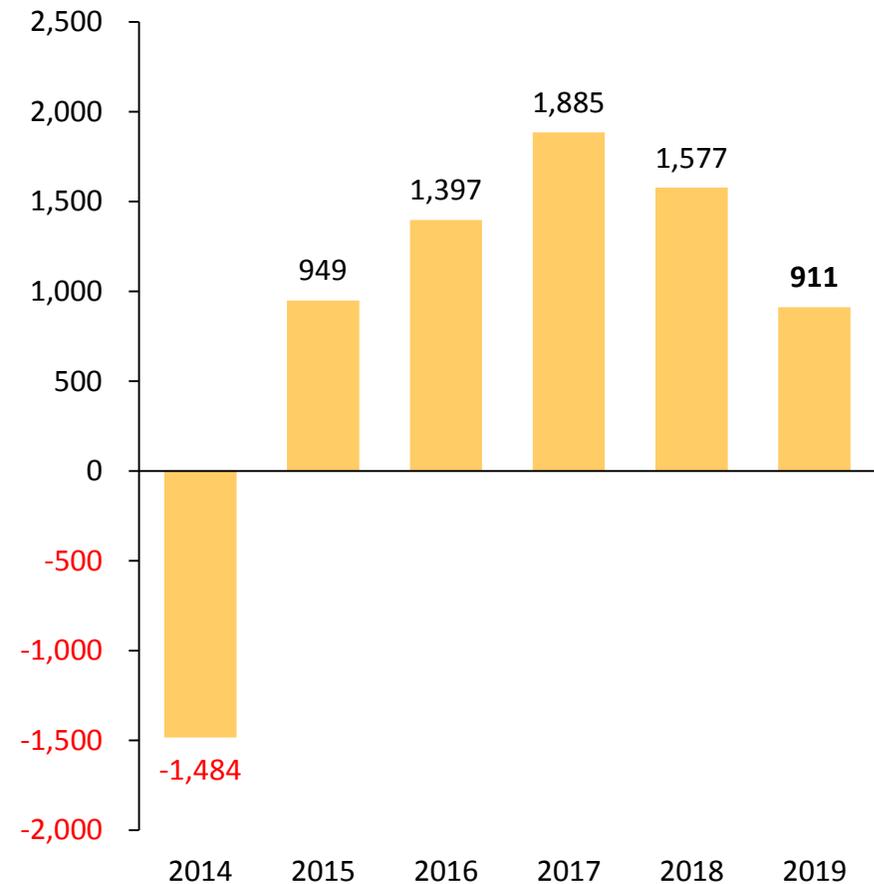
単位：百万円	‘18年12月期	売上比 (%)	‘19年12月期	売上比 (%)	前期比 (増減)
売上高	19,036	—	18,223	—	△813
売上総利益	5,275	27.7	4,411	24.2	△863
販管費	3,669	19.3	3,460	19.0	△209
営業利益	1,606	8.4	951	5.2	△654
経常利益	1,577	8.3	911	5.0	△665
親会社株主に 帰属する 当期純利益	1,479	7.8	726	4.0	△753

単位:百万円

## 売上高



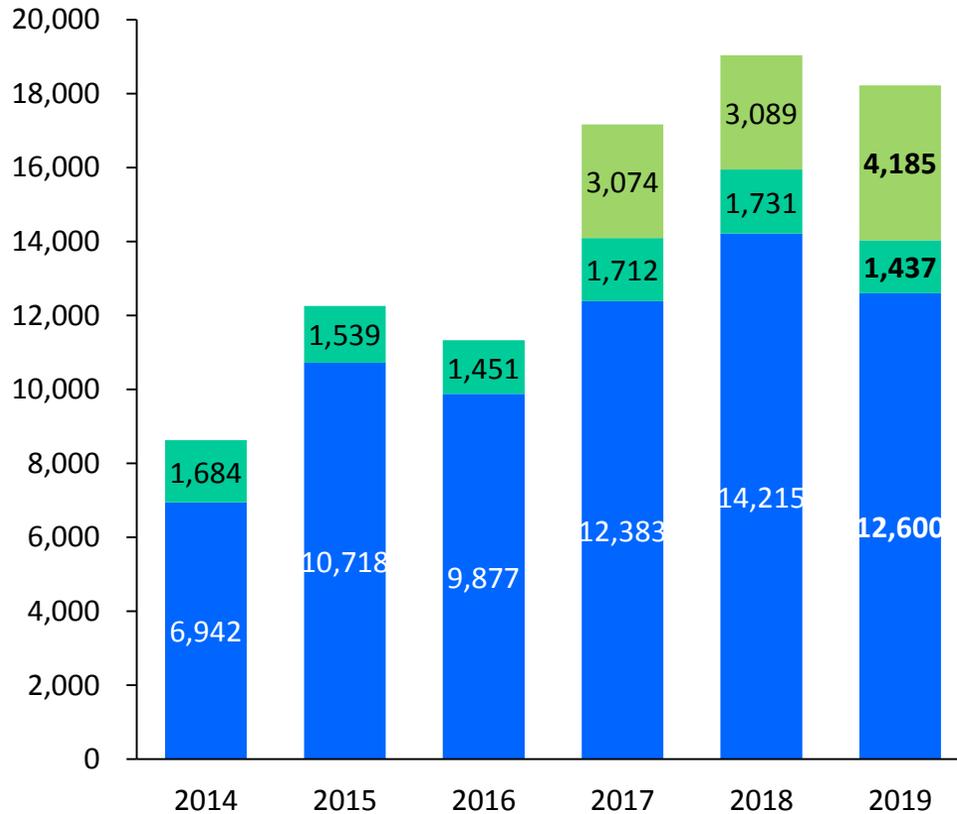
## 経常利益



単位：百万円	'18年 12月期	売上比 (%)	'19年 12月期	売上比 (%)	前期比 (増減)
売上高	19,036	-	18,223	-	△814
プロセス機器事業	14,215	74.7	12,600	69.1	△1,615
半導体装置	2,739	14.4	2,553	14.0	△186
搬送機器	4,692	24.6	5,729	31.4	1,037
洗浄機	2,400	12.6	1,905	10.5	△495
コ－タ－	4,383	23.0	2,411	13.2	△1,972
表面処理用機器事業	3,089	16.2	4,185	23.0	1,095
金型・樹脂成形事業	1,731	9.1	1,437	7.9	△294
営業利益	1,606	8.4	951	5.3	△649
プロセス機器事業	1,270	6.7	689	3.8	△581
表面処理用機器事業	300	1.6	236	1.3	△64
金型・樹脂成形事業	35	0.2	30	0.2	△5

単位:百万円

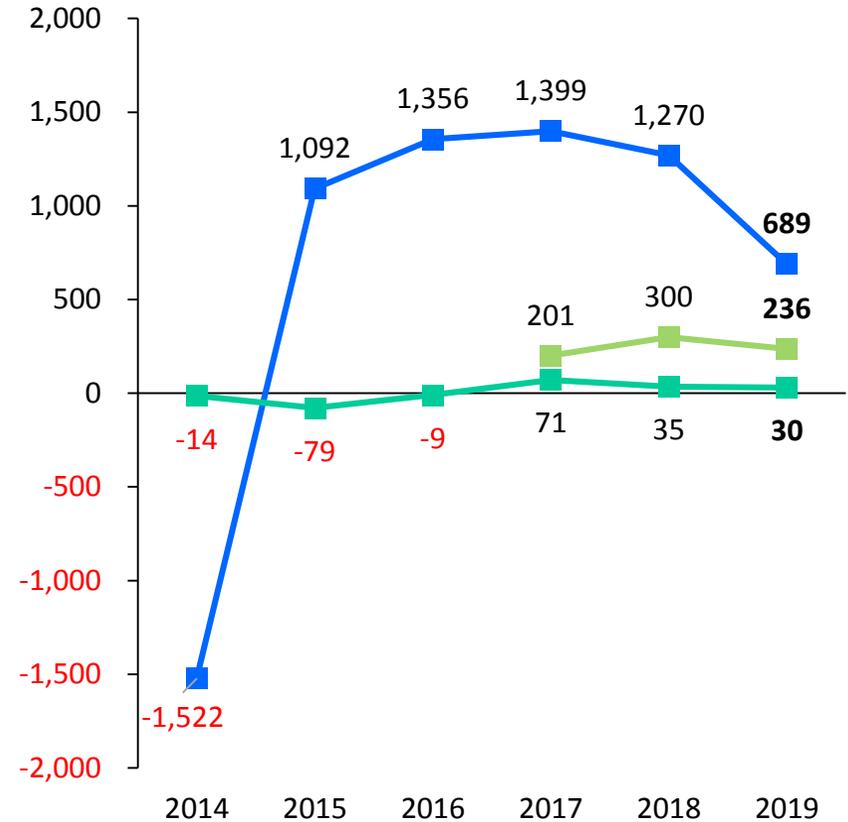
## 売上高推移



■ プロセス機器事業

■ 金型・樹脂成形事業

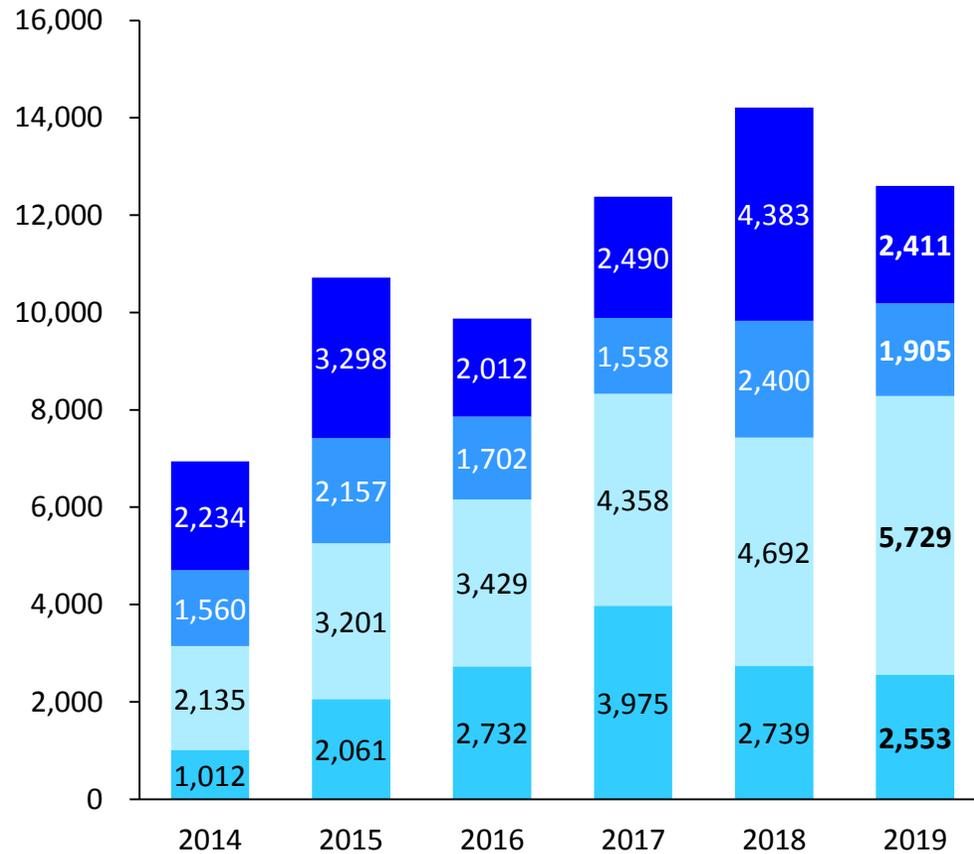
## 営業利益推移



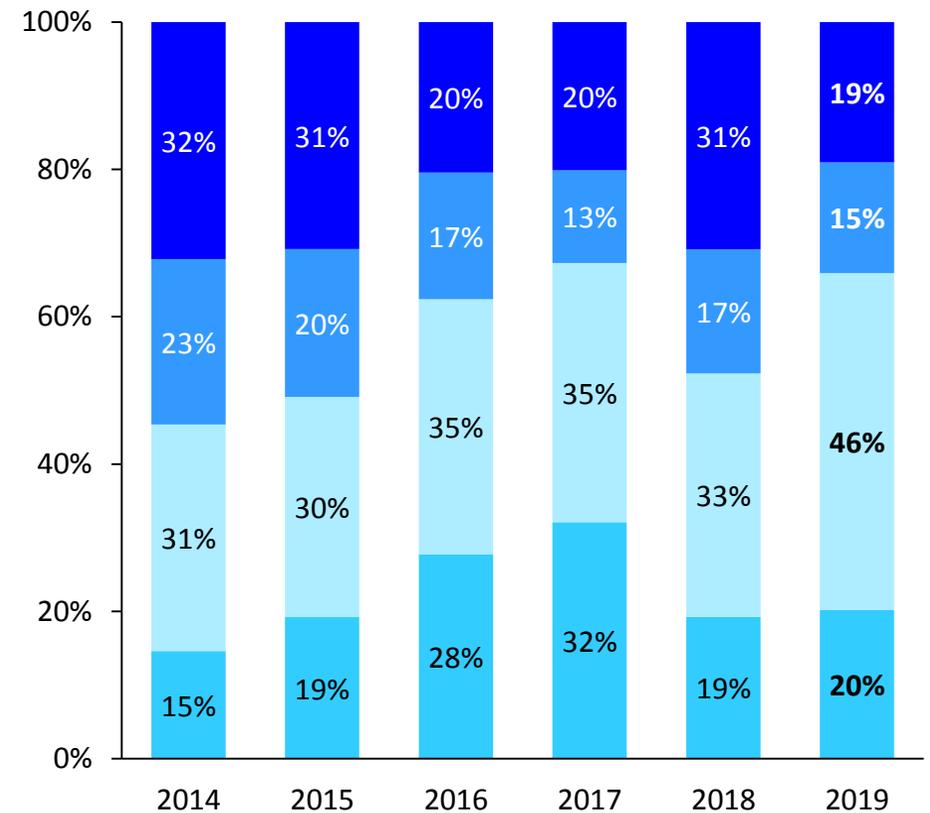
■ 表面処理用機器事業

単位:百万円

## 売上高推移



## 構成比推移



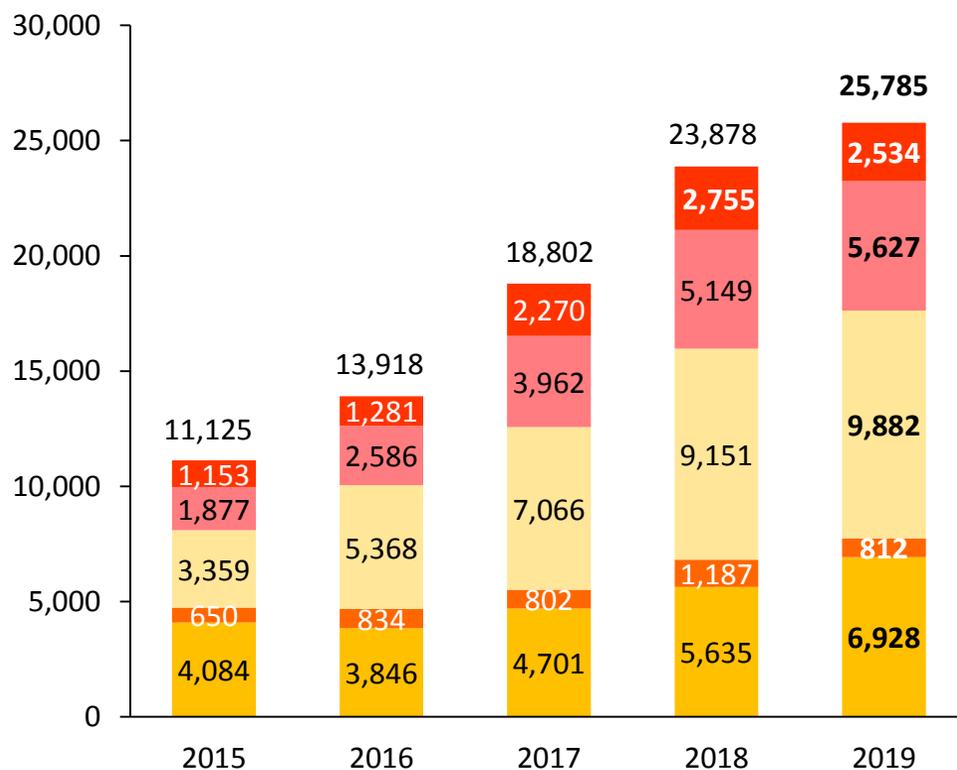
■ 半導体装置 ■ 搬送機器 ■ 洗浄機 ■ コーター

単位：百万円	'18年12月期	'19年12月期	増減
流動資産	18,243	18,856	612
有形固定資産	4,700	5,950	1,249
無形固定資産	140	162	22
投資その他資産	794	815	21
流動負債	11,706	11,814	107
固定負債	2,390	3,633	1,243
純資産	9,781	10,337	555
総資産	23,878	25,785	1,906
自己資本比率	40.3%	39.5%	△0.8P

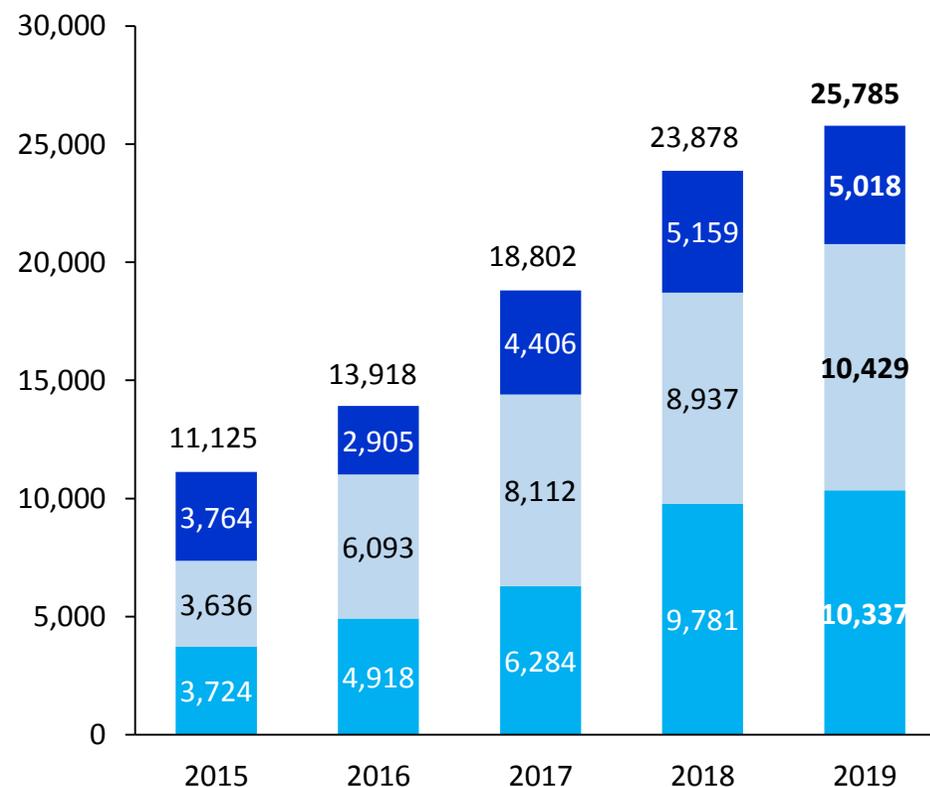
主な増減		単位：百万円
<b>資産</b>		
	<b>‘19年12月期</b>	<b>前期比</b>
現金及び預金	2,534	△220
受取手形及び売掛金	3,992	329
電子記録債権	1,634	147
仕掛品	8,462	721
建物及び構築物	3,701	1,637
<b>負債</b>		
	<b>‘19年12月期</b>	<b>前期比</b>
支払手形及び買掛金	1,672	△15
電子記録債務	1,109	△784
借入金	5,018	△140
未払金	1,245	101
前受金	5,009	2,060

単位:百万円

## 資産



## 負債・純資産



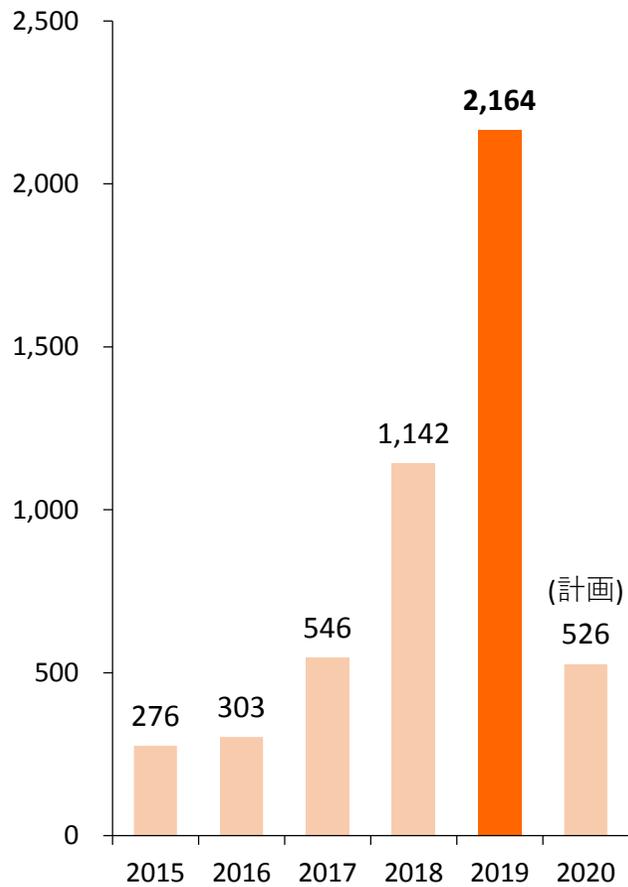
■ 固定資産      ■ その他流動資産      ■ たな卸し資産  
■ 売掛債権      ■ 現金同等物

■ 純資産      ■ その他負債      ■ 有利子負債

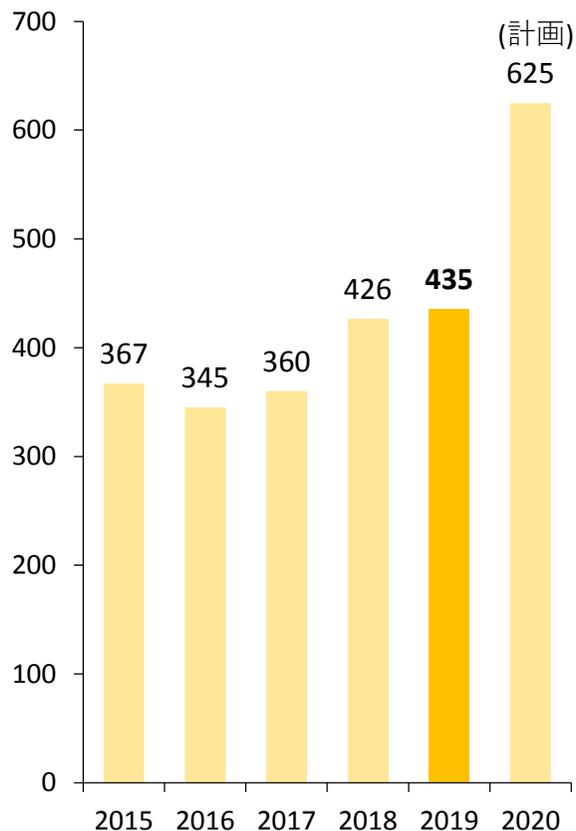
摘要	単位:百万円	‘18年12月期	‘19年12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,198	1,670
（税金等調整前当期純利益）		（1,591）	（921）
（減価償却費）		（426）	（435）
（売上債権の増減額 △：増加）		（△1,265）	（△502）
（棚卸資産の増減額 △：増加）		（△2,153）	（△759）
（仕入債務の増減額 △：減少）		（686）	（△771）
（前受金の増減額 △：減少）		（67）	（2,072）
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,057	△1,547
（有形固定資産の取得による支出）		（△1,067）	（△1,492）
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,820	△300
（長期借入による収入・短期借入金の純増減）		（1,541）	（1,325）
（長期借入金の返済による支出）		（△1,088）	（△1,465）
現金及び現金同等物に係る換算差額		△40	△14
現金及び現金同等物の増加額		523	△191
現金及び現金同等物の期末残高		2,726	2,534

単位:百万円

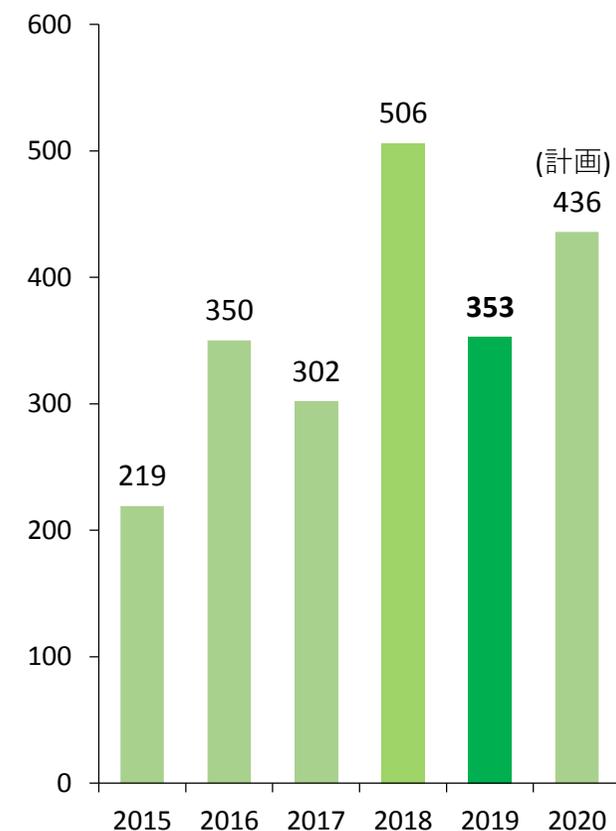
## 設備投資



## 減価償却費

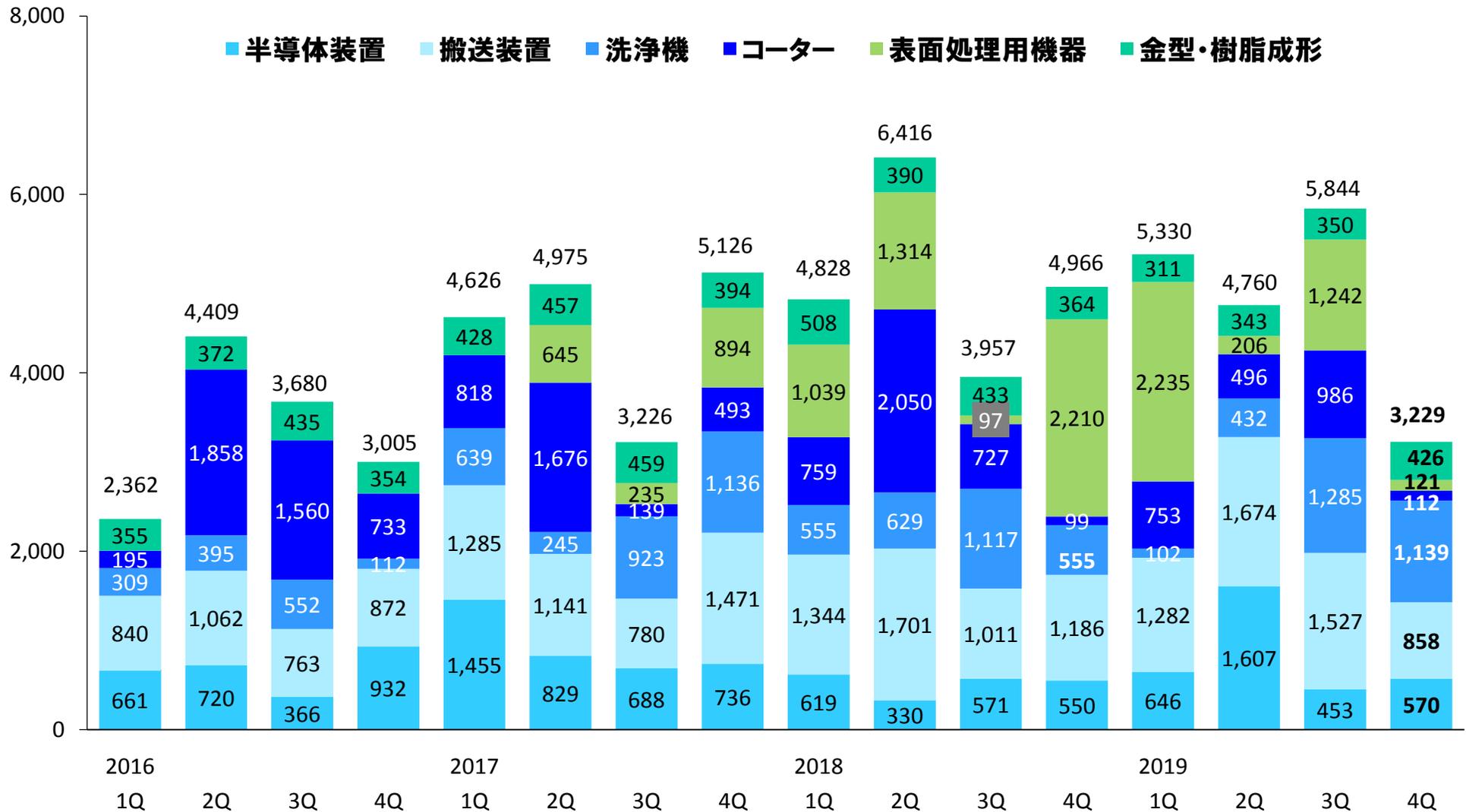


## 研究開発費



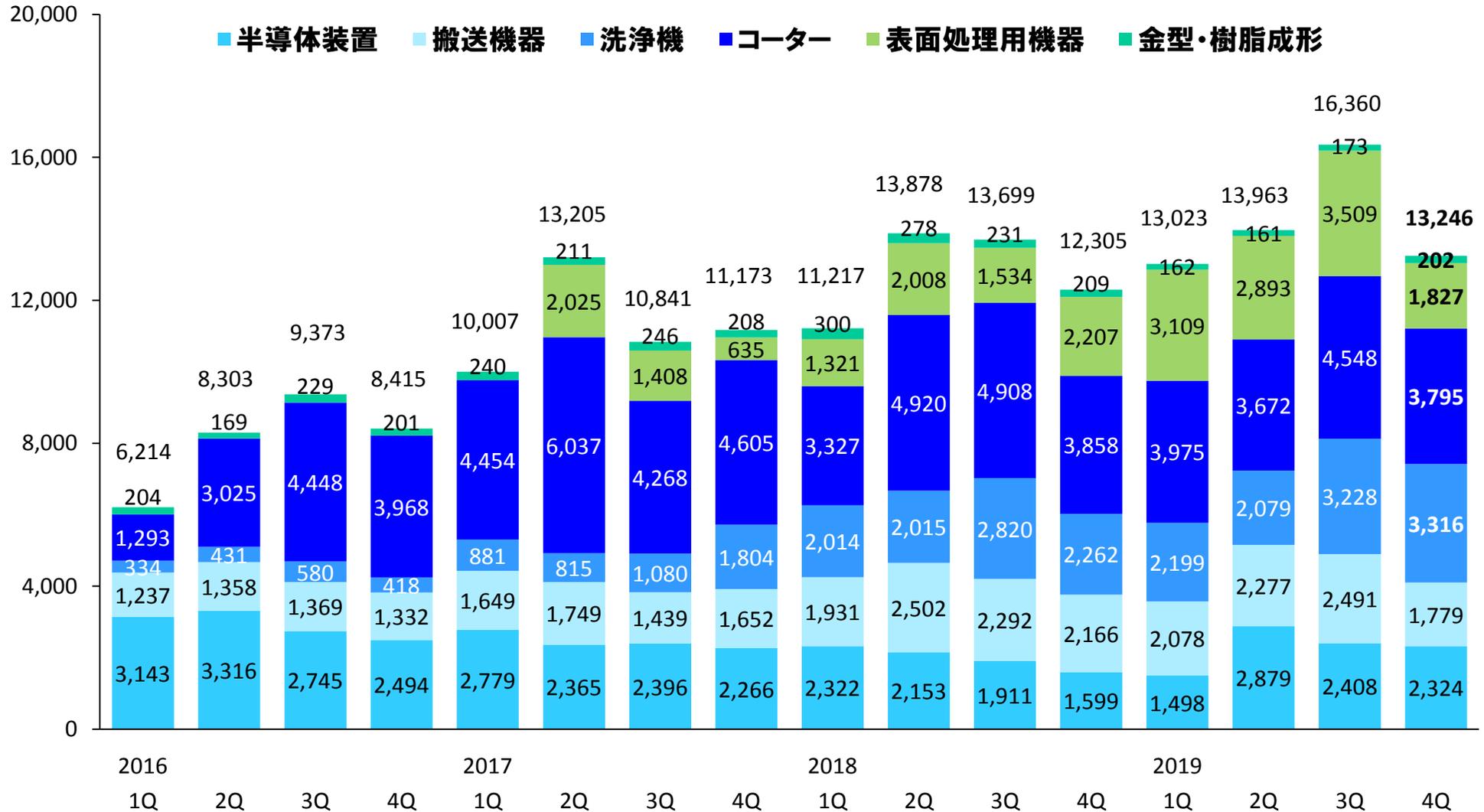
# セグメント別受注高推移

単位:百万円



# セグメント別受注残高推移

単位:百万円



➤ 会社概要

➤ 事業概要

➤ 決算概要

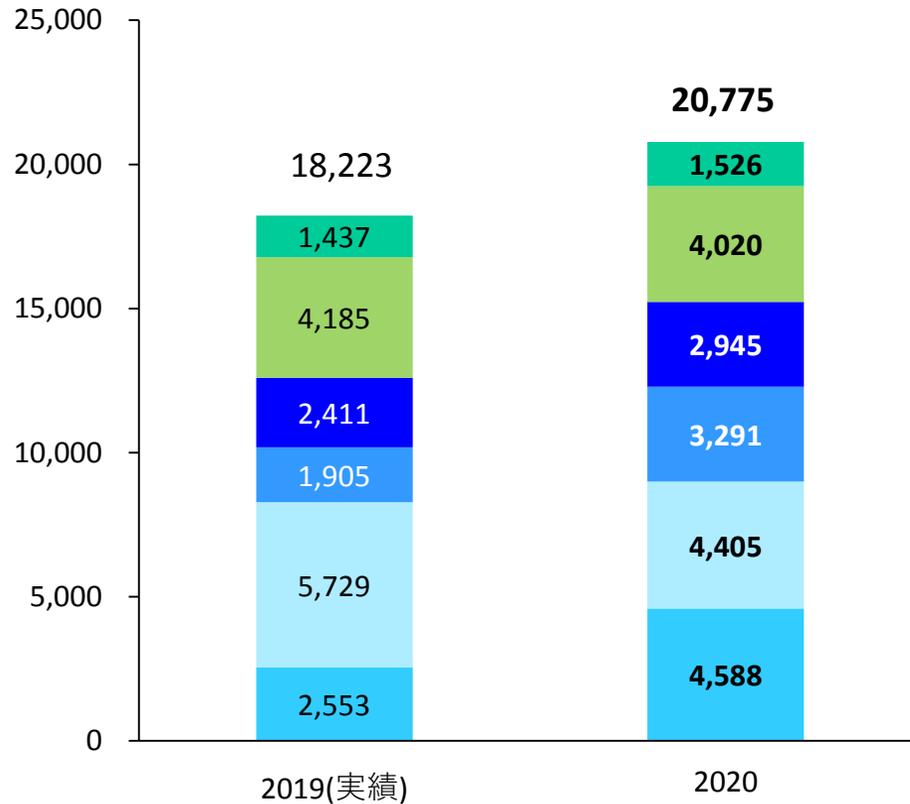
➤ **業績予想**

➤ 参考資料

単位:百万円

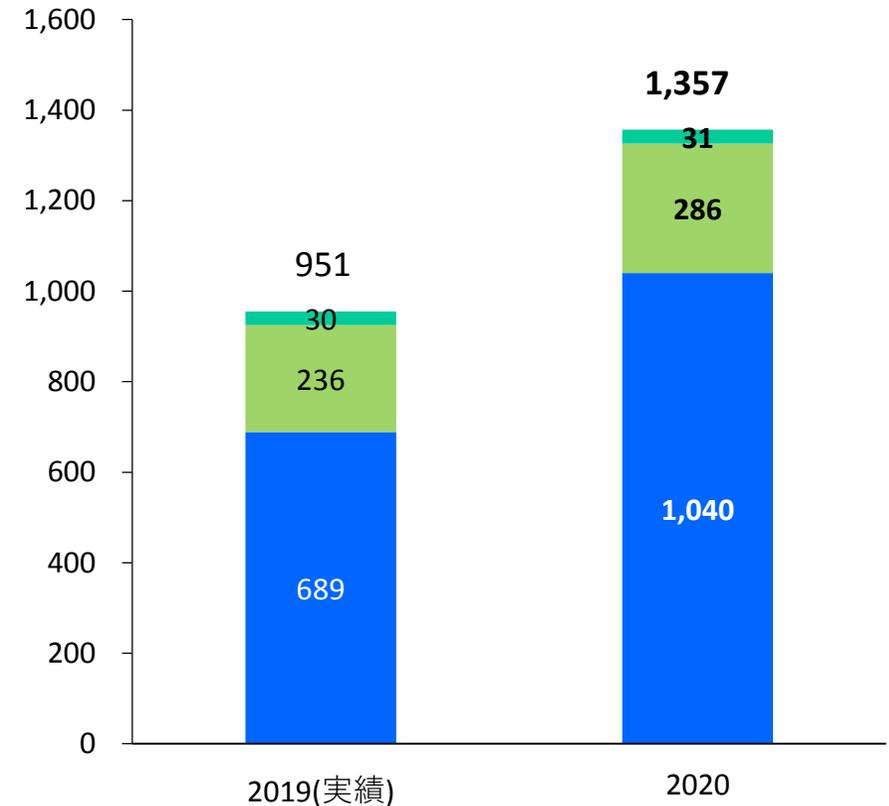
連結	第2四半期 累計	通期	前期比 (通期増減)
売上高	9,747	20,775	2,551
プロセス機器事業	6,890	15,229	2,629
表面処理用機器事業	2,076	4,020	△165
金型・樹脂成形事業	780	1,526	89
営業利益	717	1,357	405
プロセス機器事業	559	1,040	351
表面処理用機器事業	139	286	△50
金型・樹脂成形事業	18	31	1
経常利益	710	1,334	423
親会社株主に 帰属する 当期純利益	497	918	191

## 売上高



## 営業利益

単位:百万円



- 半導体装置
- 搬送機器
- 洗浄機
- コーター
- 表面処理用機器
- 金型・樹脂成形

- プロセス機器
- 表面処理用機器
- 金型・樹脂成形

## プロセス機器事業

### ◆ 半導体製造装置

- 好調なパワー半導体関連での装置受注に注力
- 新しい事業の柱となる装置の開発・市場投入

### ◆ 搬送機器

- 少量多品種・高難易度・高煩雑性製品への対応

### ◆ 洗淨機

- 洗淨装置の既受注案件の確実な履行
- バッチ洗淨装置の海外生産化

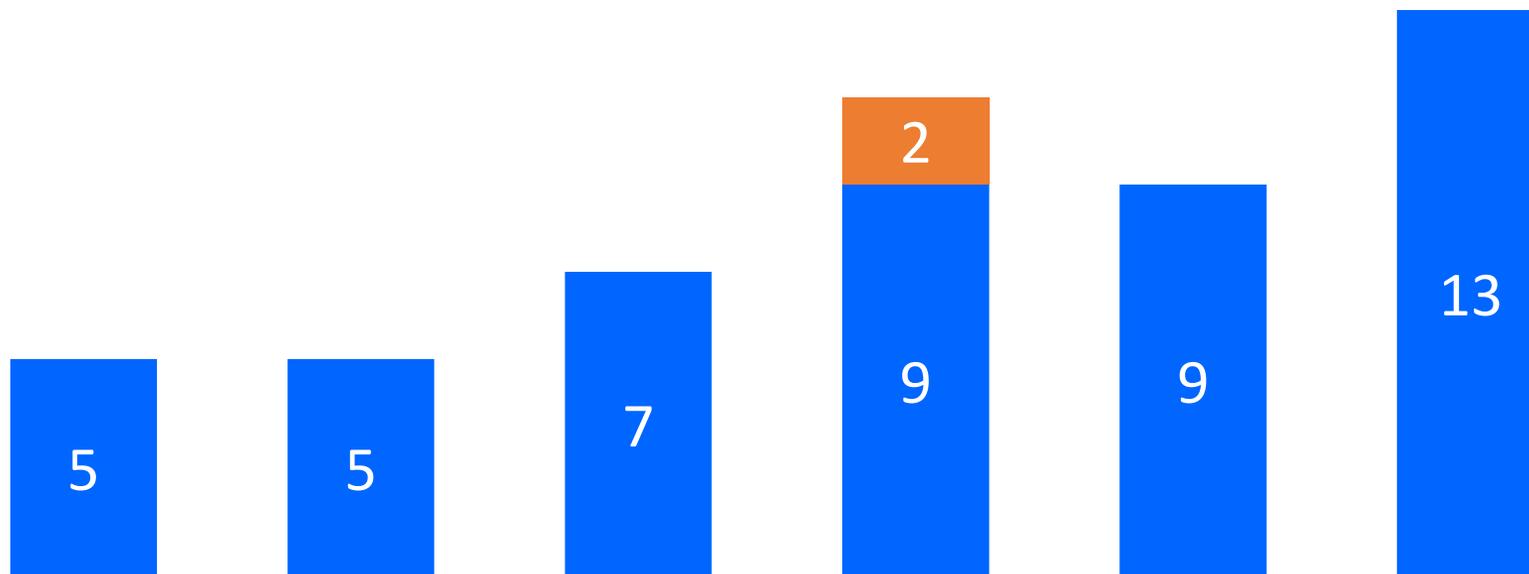
### ◆ コーター

- P L P プロセス対応装置の市場投入
- 新規材料対応の塗布装置の開発

## 表面処理用機器事業

- 半導体市場への参入

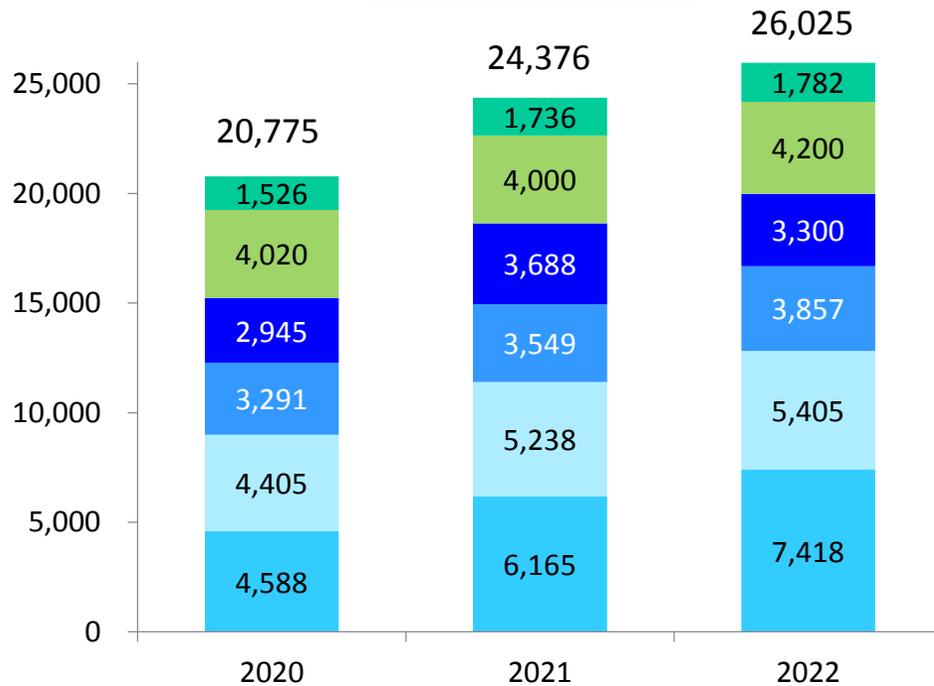
- 記念配当
- 普通配当



	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12 (予想)
当期純利益 (百万円)	1,021	1,284	1,577	1,479	726	918
1株当たり配当 金額 (円)	5.0	5.0	7.0	11.0	9.0	13.0
配当性向 (%)	1.7	4.5	5.1	8.9	16.6	19.0

※ 2017年1月1日付で1：3の株式分割を行っております。

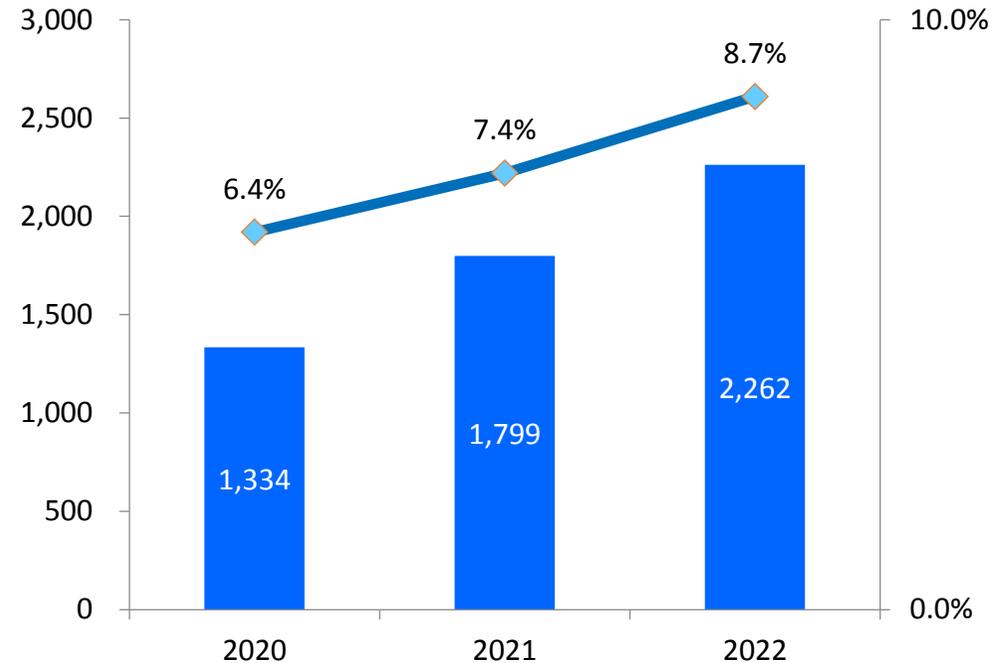
## 売上高



■ 半導体装置    ■ 搬送機器    ■ 洗浄機  
■ コーター    ■ 表面処理用機器事業    ■ 金型・樹脂成形事業

## 経常利益

単位：百万円



■ 経常利益    ◆ 経常利益率

- 新型コロナウイルス感染症による世界経済の減速懸念
- 好調なパワー半導体やプリント基板など自動車関連に注力
- 顧客ニーズの把握と求められる製品の開発
- 継続した原価低減による利益率の向上

➤ 会社概要

➤ 事業概要

➤ 決算概要

➤ 業績予想

➤ 参考資料

## ① 本社移転

2019年12月9日 岡山県井原市から岡山市北区芳賀に本社を移転しました。

### 新社屋の様子



## ② 子会社の吸収合併

2020年1月1日 子会社のアプリシアテクノロジー(株)を吸収合併しました。  
この合併により新たなグループシナジーを創出し、企業価値の向上をめざします。

**ご清聴ありがとうございました。**

**お問い合わせ先 タツモ株式会社 経営企画室**

**電話:086-239-5000 E-mail:keiki@tazmo.co.jp**